

Sehr verehrter Kunde,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es für eine effektive maschinelle Produktion unumgänglich ist, 2 - 3% Bauteilüberschuss in die Materiallieferung einzuplanen. Dies betrifft besonders passive Bauelemente, wie Kondensatoren und Widerstände in bedrahteter Bauform sowie gegurtete Bauteile - insbesondere SMD Bauteile (0201, 0402, 0603, 0805, 1206, SOT23, MiniMelf, MicroMelf, etc.). Sollten die Bauteile nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sein, sehen wir uns leider gezwungen, Leiterplatten, die nicht vollständig bestückt werden können, auszuliefern bzw. eine Serie vor Erreichen der bestellten Gesamtmenge abzubrechen. Dies ist notwendig, um Maschinenstandzeiten zu vermeiden und unsere Produktionskosten nicht ins Unermessliche zu steigern.

Es ist unbedingt notwendig, dass Ihrerseits die angelieferten Stückzahlen bereits überprüft wurden, da wir uns aus zeitlichen Gründen nicht mit dem Zählen der Bauteile beschäftigen können. Somit verringern Sie sich die Lieferzeiten und unnötiges Abklären der Fehlmengen (zusätzlicher Zeitaufwand)! Änderungsstände und Änderungsversion sollten uns detailliert und gesondert vorab mitgeteilt werden. Damit vermeiden Sie unnötige Verzögerungen und Zeitaufwendungen. Im besten Falle 2 Wochen, bevor Ihr nächster Auftrag läuft. Wir benötigen einige Zeit in unserem Hause, um bestehende Bestückungsprogramme neu zu erstellen. Bitte beachten Sie auch unsere Begleit- und Reklamationschreiben, die Sie bei jeder Platine bei der Anlieferung erhalten.

Bei Beachtung dieser Angaben aktualisieren Sie auf bequeme Art und Weise Ihre Unterlagen und verringern bei weiteren Aufträgen Ihren und unseren Zeitaufwand. So vermeiden wir gemeinsam, Besonderheiten erneut abzuklären und unsere internen Unterlagen mit Ihren mitgelieferten Unterlagen mehrfach abzugleichen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

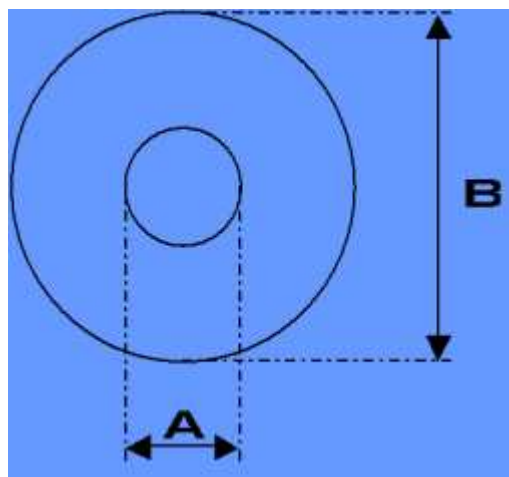
I. Vorgaben, die bei Nutzen und Layout berücksichtigt werden müssen

Platinenmarke: X / Y Koordinatenaufbereitung

Markenform:

1. Kreisförmiges Pad verzinnt
D: 1,5 mm
2. Kreisförmige Aussparung im Lötstopplack
D: 3,0 mm als Außenkreis

Skizze:



Maß A: 1,5mm

Maß B: 3mm

3. Es sind pro Platine auf jeder Seite, die bestückt wird, mind. 2 Marken anzubringen.
D=1,5 mm Abstand zum Lötstopplack kreisförmig 0,75 mm
4. Die Koordinaten der Marken sind anzugeben.

Koordinaten:

1. rechtwinklige positive Koordinaten
2. Metrische Einheiten (Millimeter)
3. Koordinaten-Ursprung in der Platinenecke
4. Positionen beziehen sich auf den Bauteilmittelpunkt (Schwerpunkt)

Aufnahme-Bohrungen:

1. Es sind pro Nutzen bzw. Platine mind. 2 (besser 3) Aufnahmebohrungen erforderlich.
2. Bohrdurchmesser D: 3,05 mm nicht durchkontaktiert!
3,05 mm Endmaß

Rand:

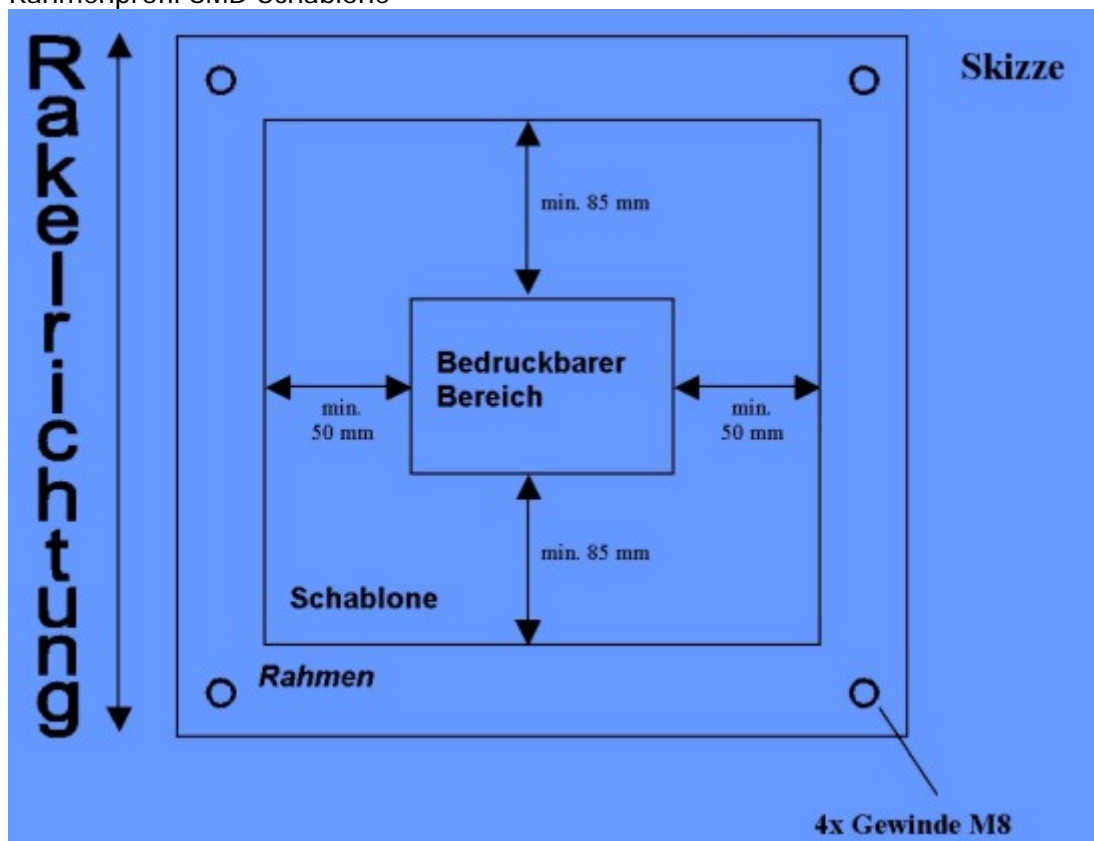
1. Alle Bauteile brauchen einen Seitenabstand zur Außenkante der Platine von min. 5 mm.
2. Andernfalls ist ein Nutzenrand von 5 mm vorzusehen. Dieser kann mit Aufnahmebohrungen versehen sein. Im Randbereich ist zum Teil aus technisch bedingten Vorgaben (Mechanik der Automaten) keine Bestückung möglich!!!

II. Kundenvorgaben für die Materialbeistellung

Das Material muss so angeliefert werden, dass eine effektive maschinelle Produktion möglich ist. Dies bedeutet:

1. SMD IC`s in Stangen oder gegurtet mit einheitlicher Polung und eindeutiger Kennzeichnung.
2. SMD Bauteile, z. B. Melf, SOT23, 1206, 0805, 0603, 0402, 0201 etc. sollen gegurtet geliefert werden.
3. Aus produktionstechnischen Gründen wird ein Gurt-Anlauf von ca. 10 cm Länge benötigt.
4. Die Gurte müssen in einwandfreiem Zustand angeliefert werden.
5. Bauteile, die lose oder in Gurtstücken angeliefert werden, können nicht ohne erheblichen Mehraufwand und somit Mehrkosten verarbeitet werden.
6. Wir behalten uns vor, diese dann aus unserem Lager zu verwenden und Ihnen in Rechnung zu stellen!

Rahmenprofil SMD Schablone



Rahmenprofil:	30 x 30 mm
Rahmengröße:	500 x 500 mm oder 530 x 530 mm
Schablone:	Richtet sich nach der Platinengröße
In Rakelrichtung:	Platinengröße + min. 85 mm an beiden Seiten
Quer zur Richtung:	Platinengröße + min. 50 mm an beiden Seiten

Begrenzungen der Platinengröße durch das Siebdruckverfahren

Spannrahmen	maximale Größe der Platine 240 x 360 mm bedruckbare Fläche 240 x 320 mm
fester Rahmen (siehe Skizze)	maximale Größe der Platine 400 x 360 mm bedruckbare Fläche 370 x 300 mm

Begrenzungen der Platinengröße durch das Reflow-Lötverfahren

Konvektionsofen (empfohlen)	maximale Breite 280 mm
Infrarot-Ofen	maximale Breite 380 mm

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage!

